

FUTURREX 半导体光刻胶 NR77-1500PY

产品名称	FUTURREX 半导体光刻胶 NR77-1500PY
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

lift-off

特性抗蚀剂显影过程中形成抗蚀剂底切厚度范围：0.7-25.0 μm容易调整抗蚀剂底切程度与曝光能量的关系对波长小于380nm的灵敏度对生产力的影响消除了对金属和电介质进行构图的干法蚀刻工艺消除了对双层抗蚀剂的需求应用领域无需RIE即可进行单层剥离工艺以对金属和电介质进行图案化设备的组件（例如垫片等）适用于MEMS、封装、生物芯片耐高温

厚度

增强附着力 厚度NR7-1000PY
0.7um-2.1um NR9-1000PY
0.7um-2.1umNR7-1500PY 1.1um-3.1um
NR9-1500PY 1.1um-3.1umNR7-3000PY
2.1um-6.3um NR9-3000PY
2.1um-6.3umNR7-6000PY 5.0um-12.2um
NR9-6000PY 5.0um-12.2umNR9-8000P

6.0 μm-25.0 μm耐温性= 180 °C

耐温性= 100 °C对于NR-

PY型负性抗蚀剂，通过曝光剂量

NR9系列抗蚀剂具有增强的附着力可以容易地控制底切程度。在低于120 °C在25 °C时易于剥离的处理温度下可在25 °C剥离NR7系抗蚀剂